



LEXCMGX

Laminate

R-G545L* R-G545E

Prepreg

R-G540L* R-G540E

*Low Dk glass cloth type

半導体パッケージ

モジュール基板向け超低損失材料

業界最高レベルの低Dk/Dfと低CTEを両立し、デバイスの進化に貢献

Dk 3.5 Df 0.003
@12GHz

CTE x,y-axis 10ppm/°C

CTE z-axis 22ppm/°C

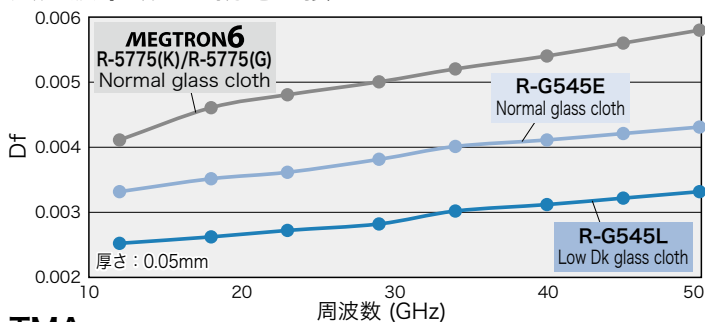
Tg(DMA) 230°C

用途

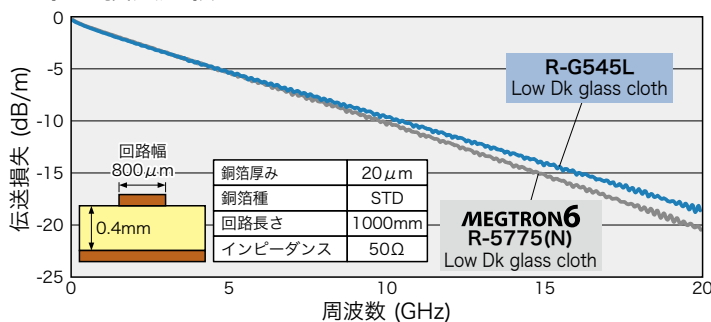
半導体パッケージ

基地局向け半導体パッケージ基板、モジュール部分 など

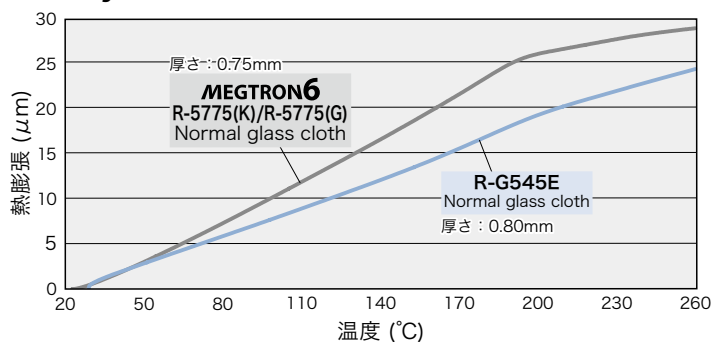
広周波帯域での誘電正接



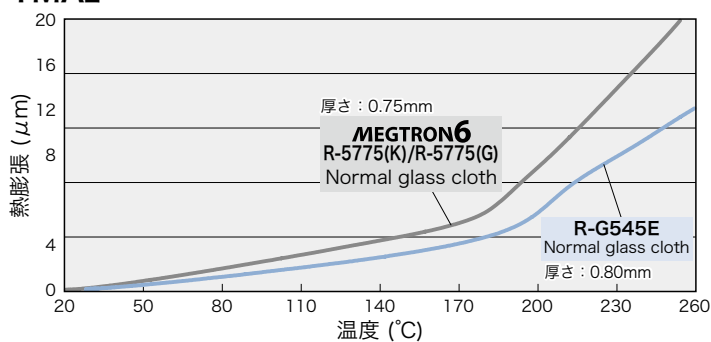
伝送損失比較



TMAxy



TMAz



一般特性

項目	試験方法	条件	単位	LEXCMGX R-G545L Low Dk glass cloth	LEXCMGX R-G545E Normal glass cloth
ガラス転移温度(Tg)	DMA*	A	°C	230	230
熱膨張係数(タテ・ヨコ方向)	社内法	A	ppm/°C	10	10
熱膨張係数(厚さ方向)					
比誘電率(Dk)	平衡型円板共振法	A	-	3.5	4.0
誘電正接(Df)					
吸水率	IPC-TM-650 2.6.2.1	D-24/23	%	0.06	0.06

試験片の厚さは0.1mmです。

※ DMA: 引張りモードでの測定

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

当社ハロゲンフリー材料は、JPCA-ES-01-2003 などの定義によるものです。

上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。